

TEC PU 2K plus

Klej poliuretanowy dwuskładnikowy

BuTec[®]
...kleje i lakiery

- bezwonny i bezrozpuszczalnikowy
- nie zawiera rozpuszczalnika, klej o emisji EC 1-R Plus
- przystosowany do ogrzewania podłogowego
- na podłoża nasiąkliwe i nienasiąkliwe
- szeroki zakres stosowania
- do długich desek
- dwuskładnikowy klej poliuretanowy 1:8



Właściwości i zakres zastosowania

Wolny od rozpuszczalników, ekologiczny dwuskładnikowy klej poliuretanowy, Klei mozaikę parkietową, 10 mm twarde parkiet, klepkę, 22 mm parkiet na pióro-wpust, parkiet płytkowy z wysokim brzegiem, gotowy parkiet, dwu- trzy- wielowarstwowy, parkiet w płytach i deskach, parkiet egzotyczny, parkiet jednostronnie lakierowany. Klei na podłożach mineralnych i drewnianych. Zalecany do długich i krótkich elementów. Minimalna temperatura podłogi przy klejeniu to +16°C i maksymalna wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu 65%.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów. Przed gruntowaniem należy je przeszlifować i odkurzyć. Stare podłoża, podłoża wyszpachlowane i podłoża z resztkami klejów należy sprawdzić pod względem nośności i wytrzymałości. Podłoże powinno mieć wytrzymałość na ścislenie większe niż 25 MPa, na odrywanie większe niż 1 MPa (badanie metodą Pull-off).

Maksymalna resztkowa wilgotność dopuszczalna podłoża przed klejeniem wynosi :

- jastrychy cementowe (wilgotność $\leq 2,0$ % CM),
- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilg $\leq 2,0$ % CM),
- podkłady anhydrytowe (wilgotność $\leq 0,5$ % CM)
- podłoże drewniane (wilgotność $\leq 8\%$ -12 % CM)

Na ogrzewaniu podłogowym wartości te ulegają dwukrotnemu zmniejszeniu. Zabrudzenia, istniejące

powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Warstwy o niskiej wytrzymałości należy usunąć za pomocą frezowania i śrutowania. Powierzchniowe rysy w podłożu należy poszerzyć, odkurzyć i zalać gruntem Tec Primer EPX. Rysy posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,8-1,4 mm. W przypadku dużych ubytków podłoże naprawić masą reparacyjną szybkoschnącą. W przypadku podłoży zawilgoconych do 4,5 %CM, zaleca się zastosować warstwę przeciw wilgotnościową z gruntu Tec Primer PU lub EPX. Grunt należy nałożyć dwukrotnie „metodą na krzyż”. Wierzchnią warstwę gruntu posypać suchym piaskiem kwarcowym - 2,5 kg piasku na 1 m² powierzchni podłoża o uziarnieniu 0,6-1,2 mm. Po związaniu gruntu, resztki piasku należy zebrać odkurzaczem.

Związany w gruncie piasek kwarcowy zwiększa przyczepność masy samopoziomującej do podłoża. Na grunt wylać min. 3 mm grubości masy samopoziomującej pod parkiet. Do tak przygotowanego podłoża można kleić parkiet. Parkiet można kleić bezpośrednio do gruntu TEC Primer PU lub EPX. Należy pamiętać o rozpoczęciu klejenia w odpowiednim czasie po zagruntowaniu, ale nie później niż 48 h. Przy stosowaniu gruntu TEC Primer D pod klej poliuretanowy klejenie jest możliwe najwcześniej po 12 godzinach lub gdy grunt jest całkowicie wyschnięty.

Klejenie

Klej znajduje się w dwóch pojemnikach. Składniki A i B należy wymieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem o obrotach max. 600 obr/min, aż do uzyskania masy o jednolitym kolorze. Klej należy zużyć do 60 minut od wymieszania. Klej rozkładać równomiernie za pomocą odpowiedniej pacy. Na przygotowane podłoże

nanosimy taką ilość kleju, aby wystarczyła do przyklejenia parkietu w czasie ok. 60 minut. Parkiet należy równomiernie ułożyć, docisnąć i dobrze zamocować. Za pomocą pacy zębatej B 3 kleimy małe elementy, parkiet mozaikowy, pacą B 11 parkiet klepkowy z drewna litego, parkiet lamelowy, parkiet i deski wielowarstwowe. Długie deski z litego drewna i parkiet pałacowy zalecamy kleić pacą B 15.

Prace związane z klejeniem należy wykonywać w okularach i gumowych rękawicach. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady u lekarza.

Czas pracy zależy od temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz od wilgotności i temperatury podłoża. Ze wzrostem temperatury i spadkiem wilgotności wzgl. powietrza ulega on skróceniu, przy niższej temperaturze i wyższej wilgotności wzgl. powietrza wydłużaniu.

Narzędzia

Paca metalowa o odpowiednim uzębieniu zg. z wytycznymi TKB.

Czyszczenie narzędzi

Metalowe narzędzia czyścić mechanicznie. Usuwanie świeżych plam kleju oraz czyszczenie narzędzi zabrudzonych świeżym klejem przeprowadzać za pomocą szmatek zwilżonych mieszaniną alkoholi, np. alkohol etylowy.

Palety

Komplet 65 opakowań po 9 kg, 1:8
(1 kg utwardzacza + 8 kg masy)

Dane techniczne

Skład:	żywice poliuretanowe
Kolor:	bezowa masa utwardzacza brązowy
Konsystencja:	półpłynna
Gęstość:	1,80 g/cm ³
Temperatura stosowania:	od +16°C do +25°C

Zużycie paca B3	0,7-1,0 kg/m ²
Zużycie paca B6	1,0-1,2 kg/m ²
Zużycie paca B 11	1,2-1,4 kg/m ²
Zużycie paca B 15	1,3-1,5 kg/m ²

Czas klejenia: do 65 minut
Możliwość szlifowania: po 24 godzinach

Czas obciążania : po 48 godzinach

Czas wstępnego odparowania: brak

GISCODE RU1

EMICODE EC1-R Plus

Składowanie: temp. powyżej +5°C

Magazynowanie: 12 miesięcy

Bezpieczeństwo i ochrona

Podczas pracy używać gumowych rękawic. Po zakończeniu prac przewietrzyć pomieszczenie. Resztek kleju w opakowaniu nie wyrzucać tylko odpowiednio i bezpiecznie utylizować. Opakowanie chronimy przed dziećmi.

Ważne wskazówki

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Niższe temperatury wydłużają czasy zastosowań, a wyższe skracają. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Bautec Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją techniczną i kartą charakterystyki produktu. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Aktualizacja 16.12.2016